

030472PC

PCT/JP 2004/011188

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

29.7.2004

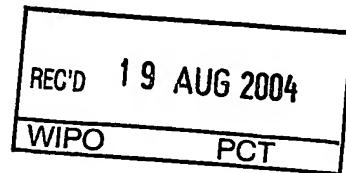
別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2003年 8月21日

出願番号
Application Number: 特願2003-208221
[ST. 10/C]: [JP 2003-208221]

出願人
Applicant(s): 長 康雄
パイオニア株式会社

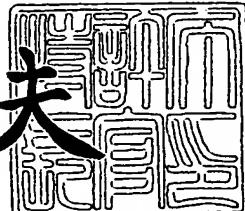


PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

2003年12月26日

今 井 康 夫



【書類名】 特許願
【整理番号】 57P0765
【提出日】 平成15年 8月21日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 C30B 29/00
C23F 1/00
C23C 14/00
G11B 9/02
G11B 9/07

【発明者】

【住所又は居所】 宮城県仙台市青葉区米ヶ袋2丁目4-5-304
【氏名】 長 康雄

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県鶴ヶ島市富士見6丁目1番1号 パイオニア株式
会社 総合研究所内
【氏名】 尾上 篤

【特許出願人】

【識別番号】 501077767
【氏名又は名称】 長 康雄

【特許出願人】

【識別番号】 000005016
【氏名又は名称】 パイオニア株式会社

【代理人】

【識別番号】 100104765

【弁理士】

【氏名又は名称】 江上 達夫
【電話番号】 03-5524-2323

【選任した代理人】

【識別番号】 100107331

【弁理士】

【氏名又は名称】 中村 聰延

【電話番号】 03-5524-2323

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 131946

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0104687

【包括委任状番号】 0206498

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 強誘電体薄膜製造方法、電圧印加エッチング装置、強誘電体結晶薄膜基板及び強誘電体結晶ウェハ

【特許請求の範囲】

【請求項1】 互いに向かい合う一の面と他の面とを有し、且つ分極方向が一方向に揃った状態で前記一の面のエッチングレートが前記他の面のエッチングレートよりも大きい強誘電体結晶に対して、

前記一の面をエッチング溶液に浸して、前記一の面に対してエッチングを進行させるエッチング工程と、

前記一の面と前記他の面との間に所定の電圧を印加する電圧印加工程とを備えることを特徴とする強誘電体薄膜製造方法。

【請求項2】 前記強誘電体結晶は、強誘電体の単結晶ウェハであることとを特徴とする請求項1に記載の強誘電体薄膜製造方法。

【請求項3】 前記強誘電体結晶は、 $\text{LiNb}_x\text{Ta}_{1-x}\text{O}_3$ （但し、 $0 \leq x \leq 1$ ）、M： $\text{LiNb}_x\text{Ta}_{1-x}\text{O}_3$ （但し、 $0 \leq x \leq 1$ 、且つMはドーピング材料）及び $\text{K}_3\text{Li}_{2-x}(\text{Nb}_{1-y}\text{Ta}_y)^{5+x}\text{O}_{15+2x}$ のうち少なくとも一つを含んでいることを特徴とする請求項1又は2に記載の強誘電体薄膜製造方法。

【請求項4】 前記強誘電体結晶の目的の厚さをd及び前記強誘電体結晶の抗電界を E_c とすると、前記所定の電圧は $E_c \times d$ であることを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載の強誘電体薄膜製造方法。

【請求項5】 前記電圧は、直流電圧であることを特徴とする請求項1から4のいずれか一項に記載の強誘電体薄膜製造方法。

【請求項6】 前記電圧は、パルス電圧であることを特徴とする請求項1から4のいずれか一項に記載の強誘電体薄膜製造方法。

【請求項7】 前記目的の厚さは $1 \mu\text{m}$ 未満であることを特徴とする請求項4に記載の強誘電体薄膜製造方法。

【請求項8】 前記エッチング溶液は、フッ酸を含んでいることを特徴とする請求項1から7のいずれか一項に記載の強誘電体薄膜製造方法。

【請求項9】 前記エッティング溶液は、導電性を有することを特徴とする請求項1から8のいずれか一項に記載の強誘電体薄膜製造方法。

【請求項10】 前記エッティング工程は、前記エッティング溶液を加熱する加熱工程を含んでなることを特徴とする請求項1から9のいずれか一項に記載の強誘電体薄膜製造方法。

【請求項11】 前記エッティング工程は、前記エッティング溶液を攪拌する攪拌工程を含んでなることを特徴とする請求項1から10のいずれか一項に記載の強誘電体薄膜製造方法。

【請求項12】 前記エッティング工程は、前記エッティング溶液を濾過する濾過工程を含んでなることを特徴とする請求項1から11のいずれか一項に記載の強誘電体薄膜製造方法。

【請求項13】 前記他の面に膜状の電極を形成する電極形成工程と、前記電極と基板とを接合する基板接合工程と、前記強誘電体結晶の一の面を研磨する研磨工程とを備え、これらの工程に続き、前記エッティング工程及び前記電圧印加工程を行うことを特徴とする請求項1から12のいずれか一項に記載の強誘電体薄膜製造方法。

【請求項14】 前記基板は、前記強誘電体結晶と比較して、熱膨張係数差が50%以内であることを特徴とする請求項13に記載の強誘電体薄膜製造方法。

【請求項15】 前記基板は、前記強誘電体結晶と同一材料を含んでいることを特徴とする請求項13又は14に記載の強誘電体薄膜製造方法。

【請求項16】 前記基板接合工程においては、前記電極と前記基板との間に接着層を介在させて接合することを特徴とする請求項13から15のいずれか一項に記載の強誘電体薄膜製造方法。

【請求項17】 前記基板接合工程においては、前記接着層と前記電極との間、並びに前記接着層と前記基板との間のうち少なくとも一方に、付着性の高い導電体下地層を介在させることを特徴とする請求項16に記載の強誘電体薄膜製造方法。

【請求項18】 前記基板はガラス基板であり、前記基板接合工程におい

では、前記電極と前記基板とを陽極接合により直接接合することを特徴とする請求項13又は14に記載の強誘電体薄膜製造方法。

【請求項19】 前記基板接合工程においては、前記電極と前記基板との間にガラス膜を介在させて、前記電極と前記基板とを陽極接合により接合することを特徴とする請求項13又は14に記載の強誘電体薄膜製造方法。

【請求項20】 前記研磨工程において、前記一の面を研磨した後、該一の面に対し平滑化処理を施すことを特徴とする請求項13から19のいずれか一項に記載の強誘電体薄膜製造方法。

【請求項21】 請求項1から20のいずれか一項に記載の強誘電体薄膜製造方法における前記エッティング工程及び前記電圧印加工程において用いられる電圧印加エッティング装置であって、

前記一の面を前記エッティング溶液に浸すための容器と、

前記一の面以外の部分を前記エッティング溶液よりシールするシール手段と、

前記一の面と前記他の面との間に前記所定の電圧を印加する電源と、

前記電源の一の出力端子と前記一の面とを電気的に接続する第1接続手段と、

前記電源の他の出力端子と前記他の面とを電気的に接続する第2接続手段と

を備えることを特徴とする電圧印加エッティング装置。

【請求項22】 前記シール手段は、前記一の面上の外周部または一の面の外縁に圧着される耐酸性のOリングであることを特徴とする請求項21に記載の電圧印加エッティング装置。

【請求項23】 前記エッティング溶液を加熱する加熱手段を更に備えることを特徴とする請求項21又は22に記載の電圧印加エッティング装置。

【請求項24】 前記エッティング溶液を攪拌する攪拌手段を更に備えることを特徴とする請求項21から23のいずれか一項に記載の電圧印加エッティング装置。

【請求項25】 前記エッティング溶液を濾過する濾過手段を更に備えることを特徴とする請求項21から24のいずれか一項に記載の電圧印加エッティング装置。

【請求項26】 基板と、

該基板上に形成される電極と、
該電極上に形成され、且つ厚さが $1 \mu\text{m}$ 未満の強誘電体結晶とを備えた強誘電体結晶薄膜基板であって、
当該基板の表面全体の面積が 10 mm^2 以上であることを特徴とする強誘電体結晶薄膜基板。

【請求項 27】 前記基板はガラス基板であって、前記基板と前記電極とは陽極接合により直接接合されていることを特徴とする請求項 26 に記載の強誘電体結晶薄膜基板。

【請求項 28】 前記強誘電体結晶は、分極方向が表面に対して垂直方向であって、且つ同一の方向を向いていることを特徴とする請求項 26 又は 27 に記載の強誘電体結晶薄膜基板。

【請求項 29】 基板と、
該基板上に形成される電極と、
該電極上に形成され、且つ厚さが $1 \mu\text{m}$ 未満の強誘電体結晶と
を備えることを特徴とする強誘電体結晶ウェハ。

【請求項 30】 前記基板はガラス基板であって、前記基板と前記電極とは陽極接合により直接接合されていることを特徴とする請求項 29 に記載の強誘電体結晶ウェハ。

【請求項 31】 前記強誘電体結晶は、分極方向が表面に対して垂直方向であって、且つ同一の方向を向いていることを特徴とする請求項 29 又は 30 に記載の強誘電体結晶ウェハ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、強誘電体薄膜製造方法、該強誘電体薄膜製造方法において用いられる電圧印加エッティング装置、並びに該強誘電体薄膜製造方法により製造される薄膜を含んでなる強誘電体結晶薄膜基板の技術分野に属する。

【0002】

【従来の技術】

従来より高密度大容量でランダムアクセスが可能な記録再生装置として、光ディスク措置やHDD (Hard Disc Drive) 装置が知られている。

【0003】

光記録は、レーザを光源とした光ピックアップを用い、ディスクに形成された有機色素又は相変化材料の層にピットを形成することによってデータを記録し、又、ピットの有無によって、これらの層の反射率が異なることを利用してデータの再生を行うものである。或いは、光磁気効果を利用してデータの記録再生を行うものもある。しかしながら、光ピックアップは、HDDの磁気ヘッドと比べて大きく、高速読み出しには不適である。又、ピットの大きさは光の回折限界で規定されるため、記録密度は 50 Gbit/inch² 程度が限界とされる。

又、HDDに代表される磁気記録の長手記録では近年、GMR (Giant Magnetic Resistance) によるMRヘッドが実用化されており、更に垂直磁気記録を用いることで光ディスク以上の記録密度が期待されている。しかしながら、磁気記録情報の熱揺らぎや符号反転部分でのプロッホ壁の存在、更にこれらを考慮したパターンドメディアを用いても記録密度は 1 Tbit/inch² 程度が限界とされている。

【0004】

一方、近年、誘電体記録媒体をナノスケールで分析する SNDM (Scanning Nonlinear Dielectric Microscopy: 走査型非線形誘電率顕微鏡法) を利用した記録再生装置の技術について、本願発明者等によって提案されている。SNDMにおいては、AFM (Atomic Force Microscopy) 等に用いられる先端に微小な探針を設けた導電性のカンチレバー (プローブ) を用いることで、測定に係る分解能を、サブナノメートルにまで高めることが可能である。近年では、SNDMの技術を応用して、データを、強誘電体材料からなる記録層を有する記録媒体に記録する超高密度記録再生装置の開発が進められている (特許文献1参照)。

【0005】

【特許文献1】

特開2003-085969号公報

【0006】**【発明が解決しようとする課題】**

ところで、係る超高密度記録再生装置では、カンチレバーから強誘電体記録媒体への電圧印加による局所的な分極反転を行い、これを用いて記録情報としている。このときの記録動作においては、記録媒体の強誘電体材料の抗電界を E_c 、強誘電体材料の厚さを d とすると、 $E_c \leq V/d$ の条件を満たす電圧 V を、強誘電体材料に印加することで、分極反転による記録情報の記録が可能となる。従って、強誘電体材料の厚さ d が小さいほど、記録動作のための印加電圧の低電圧化を図ることができる。

【0007】

よって、係る低電圧化を実現するために、強誘電体材料の厚さ d は、例えば数十ナノメートルの薄さを有することが望ましい。更に、係る強誘電体記録媒体を製造するには、基板上に、電極及び強誘電体材料等が積層されたウェハを形成し、これを分断することが好ましい。この場合には、ウェハの状態で、強誘電体材料を数十ナノメートルの薄さで均一化する必要がある。なぜなら、製造された全ての強誘電体記録媒体の強誘電体材料の厚さが均一でないと、情報を記録するために印加する印加電圧の統一化を図ることができず、超高密度記録再生装置の製品化を困難とするなどの不都合があるからである。

【0008】

しかしながら、従来から薄膜の形成に用いられているゾルゲル法やスパッタ法等においては、強誘電体材料に係る均一な薄膜を作成することが困難或いは不可能であるという技術的な問題点を有している。より具体的には、マイクロメートルオーダーでは平坦化できたとしても、ナノメートルオーダーでは無視できない凹凸等ないし厚さのばらつきが発生することとなる。即ち、マイクロメートルオーダーでの実用がなされている Fe-RAM (Ferroelectric Random Access Memory) 等の用途に適した強誘電体材料の形成は可能だとしても、ナノメートルオーダーの厚さを有する強誘電体材料を用いた超高密度記録媒体の用途に適した強誘電体材料の形成は困難或いは不可能であるという技術的な問題を有していることとなる。

【0009】

これに対し、本願発明者等の研究により、強誘電体の単結晶をCMP (Chemical Mechanical Polishing) 法による機械研磨とドライエッチングとを組み合わせた薄膜形成法が開発された。該薄膜形製法によれば、強誘電体を100nm程度にまで薄くし、且つ1.5Tbit/inch²もの均一記録が可能であることが判明している。しかしながら、このような薄膜形成方法によって、例えばφ3インチ程度のウェハ全体の厚さ分布をナノメートルオーダーの精度で均一化するためには、厳密な工程管理が必要とされ、コストが大幅に増加するという技術的な問題点を有している。

【0010】

本発明は上記に例示したような問題点に鑑みなされたものであり、例えば厚さがサブマイクロメートルオーダーないし数十ナノメートルオーダーで、均一な厚さ分布を有する強誘電体材料を効率よく製造することを可能とする強誘電体薄膜製造方法、該強誘電体薄膜製造方法において用いられる電圧印加エッチング装置、並びに該強誘電体薄膜製造方法により製造される薄膜を含んでなる誘電体記録媒体を提供することを課題とする。

【0011】**【課題を解決するための手段】**

上記課題を解決するために請求項1に記載の強誘電体薄膜製造方法は、互いに向かい合う一の面と他の面とを有し、且つ分極方向が一方向に揃った状態で前記一の面のエッティングレートが前記他の面のエッティングレートよりも大きい強誘電体結晶に対して、前記一の面をエッティング溶液に浸して、前記一の面に対してエッティングを進行させるエッティング工程と、前記一の面と前記他の面との間に所定の電圧を印加する電圧印加工程とを備える。

【0012】

上記課題を解決するために請求項21に記載の電圧印加エッティング装置は、請求項1から20のいずれか一項に記載の強誘電体薄膜製造方法における前記エッティング工程及び前記電圧印加工程において用いられる電圧印加エッティング装置であって、前記一の面を前記エッティング溶液に浸すための容器と、前記一の面以外

の部分を前記エッティング溶液よりシールするシール手段と、前記一の面と前記他の面との間に前記所定の電圧を印加する電源と、前記電源の一の出力端子と前記一の面とを電気的に接続する第1接続手段と、前記電源の他の出力端子と前記他の面とを電気的に接続する第2接続手段とを備える。

【0013】

上記課題を解決するために請求項26に記載の強誘電体結晶薄膜基板は、基板と、該基板上に形成される電極と、該電極上に形成され、厚さが $1\mu\text{m}$ 未満の強誘電体結晶とを備えた強誘電体結晶薄膜基板であって、当該基板の表面全体の積が 10mm^2 以上である。

【0014】

上記課題を解決するために請求項29に記載の強誘電体結晶ウェハは、基板と、該基板上に形成される電極と、該電極上に形成され、且つ厚さが $1\mu\text{m}$ 未満の強誘電体結晶とを備える。

【0015】

本発明の作用及び他の利得は次に説明する実施の形態から明らかにされよう。

【0016】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について説明する。

【0017】

本発明の強誘電体薄膜製造方法に係る実施形態は、互いに向かい合う一の面と他の面とを有し、且つ分極方向が一方向に揃った状態で一の面のエッティングレートが他の面のエッティングレートよりも大きい強誘電体結晶に対して、一の面をエッティング溶液に浸して、一の面に対してエッティングを進行させるエッティング工程と、一の面と他の面との間に所定の電圧を印加する電圧印加工程とを備える。

【0018】

本発明の強誘電体薄膜製造方法に係る実施形態によれば、均一な厚さを有しており、且つナノメートルオーダーでの平坦性を有する強誘電体の薄膜を製造することが可能となる。尚、本発明に係る「強誘電体」とは電圧を印加することで自発分極の方向を変化させ、その後電圧の印加を停止しても分極の方向を維持する

誘電体をいう。

【0019】

そして、本実施形態で用いられる強誘電体は特に、一の面のエッチングレートが他の面のエッチングレートと比較して大きい。即ち、一の面は他の面と比較してエッチングされやすいという特徴を有する。このエッチングレートの相違は、強誘電体結晶が有する自発分極の方向に応じて定まる。例えば、Z-cut LiTaO₃を強誘電体結晶として用いた場合を説明する。このとき、一の面及び他の面に対して垂直となるような分極方向を有し、且つ、分極方向が強誘電体結晶の全体に亘って揃っている場合、またはこれに近い構造を有している場合には、分極方向のプラス側に位置するプラス面の方が、分極方向のマイナス側に位置するマイナス面よりも、エッチングされにくい。このような場合には、マイナス面が一の面であり、プラス面が他の面である。なお、強誘電体結晶がこのような構造ないし性質を有するかは、強誘電体結晶の種類によって異なる。本実施形態では、上述したような構造ないし性質を有する強誘電体結晶を選択して、用いることが望ましい。

【0020】

そして、エッチング工程において、強誘電体結晶の一の面をエッチング液に浸することで、該一の面に対してエッチングを施す。このとき、エッチング工程においてエッチングすべきでない面（例えば一の面を除く他の部分）は、エッチング溶液が触れないように、何らかの措置を施すことが望ましい。

【0021】

そして、エッチング工程を行いながら、電圧印加工程を行う。電圧印加工程においては、強誘電体結晶の一の面と他の面との間に所定の大きさの電圧を印加する。このとき、エッチング溶液が触れる一の面とエッチング溶液が触れない他の面とは、電気的に絶縁されていることが好ましい。

【0022】

ここで、強誘電体結晶は自発分極を有し、外部から自発分極に対して逆方向の電界を印加し、且つ該電界の大きさが一定の大きさを超えたときに、結晶の分極方向が反転する性質を有する。この分極方向の反転を引き起こす電圧の大きさは

物質固有のものであり、この電圧により当該物質中に発生する電界を抗電界といふ。そして、分極方向の反転を引き起こすために強誘電体結晶に印加する電圧の大きさは、強誘電体結晶の厚さによって異なる。本実施形態では、説明の便宜上、強誘電体結晶の抗電界を「 E_c 」とし、強誘電体結晶の分極方向が実際に反転するときに印加する電圧を「分極反転電圧 e 」として説明を進める。例えば後述の LiTaO_3 (タンタル酸リチウム) の抗電界 E_c は 22 kV/mm 程度である。この強誘電体結晶の厚さを 100 nm にすると、分極反転電圧 e は、 2.2 V 程度となる。

【0023】

電圧印加工程において、強誘電体結晶に印加する所定の電圧 V は、強誘電体結晶に設定したい厚さを目的厚さ d とすると、 $V = E_c \times d$ となるように設定することが望ましい。この電圧 V の印加によって強誘電体結晶中に形成される電界は、強誘電体結晶が目的厚さ d になったときの分極反転電圧 e の印加によって強誘電体結晶中に形成される電界とほぼ一致する。例えば上述した LiTaO_3 (タンタル酸リチウム) の目的の厚さを 100 nm に設定したい場合には、所定の電圧 V を 2.2 V (即ち、 $22 [\text{kV/mm}] \times 100 [\text{nm}]$) に設定する。

【0024】

さて、エッティング工程において、エッティングが進行すると、強誘電体結晶は一面側から溶けていき、その厚さが徐々に小さくなる。これに伴って、強誘電体結晶の分極反転電圧 e も徐々に小さくなる。そして、強誘電体結晶の厚さが目的厚さ d に達すると、強誘電体結晶の分極反転電圧 e が、そのときに印加している電圧 V とほぼ一致する。この結果、強誘電体結晶の厚さが目的厚さ d に達したときに、強誘電体結晶の分極方向が反転する。強誘電体結晶の分極方向が反転すると、一面のエッティングレートが大幅に小さくなるので、実質的にエッティングの進行が停止する。従って、強誘電体結晶に印加した所定の電圧 V により、当該強誘電体結晶の一面の全域に均一な電界が形成されているとすれば、強誘電体結晶の厚さは、全面に亘って均一な厚さ d となる。なお、基板のエッティング面 (即ち、一面) への電界印加は、イオン化したエッティング液を一方の電極として行われる。この際、エッティング液は一面にくまなく行き渡るため、エッティング中

の電界印加を一の面全面に対して均一に行うことが可能である。

【0025】

このように、本実施形態に係る強誘電体薄膜製造方法によれば、分極方向の反転により一の面のエッティングレートが大幅に小さくなるという性質を用いて、強誘電体結晶の厚さを目的厚さに設定する。このため、厚さがサブマイクロメートルオーダーないし数十ナノメートルオーダー、例えば $1\text{ }\mu\text{m}$ 未満の強誘電体結晶の薄膜を形成することができる。更に、強誘電体結晶の一の面の面積が広い場合（例えば、ウェハ表面の面積と同等な面積である場合）でも、その厚さを全面に亘って均一にすることができる。

【0026】

本発明の強誘電体薄膜製造方法に係る実施形態の一の態様では、強誘電体結晶は、強誘電体の単結晶ウェハである。

【0027】

この態様によれば、上述の如く厚さがサブマイクロメートルオーダーないし数十ナノメートルオーダーであって、且つ、広い面積に亘って均一な厚さを有する強誘電体単結晶ウェハを製造することが可能となる。例えば、ウェハの表面の全部またはその外周部分を除く部分を均一な厚さとすることができます。例えば、強誘電体記録媒体を製造する場合には、この薄膜化させた強誘電体結晶ウェハを用いる。これにより、厚さの揃った強誘電体記録媒体を大量に生産することができ、強誘電体記録媒体の量産が可能となる。

【0028】

本発明の強誘電体薄膜製造方法に係る実施形態の他の態様では、強誘電体結晶は、 $\text{LiNb}_x\text{Ta}_{1-x}\text{O}_3$ （但し、 $0 \leq x \leq 1$ ）、 $\text{M:LiNb}_x\text{Ta}_{1-x}\text{O}_3$ （但し、 $0 \leq x \leq 1$ 、且つMはドーピング材料）、及び $\text{K}_3\text{Li}_{2-x}(\text{Nb}_{1-y}\text{Ta}_y)_{5+x}\text{O}_{15+2x}$ のうち少なくとも一つを含んでいる。

【0029】

これらの強誘電体結晶は、分極の方向の相違によりエッティングレートに大きな差があることが確認されている。これらの強誘電体結晶を用いることにより、分極方向の反転によるエッティングレートの変化させる上述の製造方法を実現でき、

且つ当該製造方法により奏される効果を大きく引き出すことができる。すなわち、これらの強誘電体結晶を用いることにより、厚さがサブマイクロメートルオーダーないし数十ナノメートルオーダーであって、且つ広い面積において均一な厚さを有する強誘電体結晶薄膜を安価に、確実かつ高精度に製造することができる。

【0030】

尚、 $\text{LiNb}_x\text{Ta}_{1-x}\text{O}_3$ にドーピングされる材料Mとして、例えばMgOやZnO等を用いることができる。但し、それ以外の材料であっても、 $\text{LiNb}_x\text{Ta}_{1-x}\text{O}_3$ にドーピングすることは可能であり、上述の各種利益を享受することができる。

【0031】

本発明の強誘電体薄膜製造方法に係る実施形態の他の態様では、電圧印加工程で強誘電体結晶に印加する電圧は、直流電圧である。

【0032】

この態様によれば、所定の電圧の大きさを有する直流電圧を印加しながらエッチングを行うことで、上述の如く厚さがサブマイクロメートルオーダーないし数十ナノメートルオーダーであって、且つ広い面積において均一な厚さを有する強誘電体結晶薄膜を製造することが可能となる。

【0033】

本発明の強誘電体薄膜製造方法に係る実施形態の他の態様では、電圧印加工程で強誘電体結晶に印加する電圧は、パルス電圧である。

【0034】

例えば連続的に電圧を印加すると、エッチング溶液中において電気化学的効果が生じうる。この現象により、本来エッチングレートが低いはずの他の面（或いは、分極が反転した後の一の面）のエッチングレートが高くなるおそれがある。これに対し、本態様によれば、エッチング中に電気化学的な効果を生じさせることなく、適切に一の面（分極反転していない一の面）にエッチングを施すことが可能となる。

【0035】

本発明の強誘電体薄膜製造方法に係る実施形態の他の態様では、強誘電体結晶の目的厚さ d は、 $1 \mu\text{m}$ 未満である。

【0036】

この態様によれば、 $1 \mu\text{m}$ 未満の均一な厚さを有する薄膜を製造或いは量産することが可能となる。強誘電体結晶ウェハに対して上記エッチング工程及び電圧印加工程を行えば、 $1 \mu\text{m}$ 未満の均一な厚さを有する強誘電体結晶ウェハを製造することができる。

【0037】

本発明の強誘電体薄膜製造方法に係る実施形態の他の態様では、エッティング溶液は、フッ酸を含んでなる。

【0038】

この態様によれば、強誘電体結晶のように比較的エッティングされにくい材料であっても、適切にエッティングを施すことが可能となる。

【0039】

本発明の強誘電体薄膜製造方法に係る実施形態の他の態様では、エッティング溶液は、導電性を有する。

【0040】

この態様によれば、一の面と他の面との間に電圧を印加する際に、エッティング溶液を電圧付与の媒介として利用することが可能となる。例えば、エッティング溶液に電圧を付与する構成とすれば、エッティング溶液に接している強誘電体結晶の一の面の全体に均一に電圧を印加することができる。従って、エッティング工程および電圧印加工程において、強誘電体結晶の厚さを均一にでき、平坦な面を形成することができる。

【0041】

本発明の強誘電体薄膜製造方法に係る実施形態の他の態様では、エッティング工程は、エッティング溶液を加熱する加熱工程を含んでなる。

【0042】

この態様によれば、エッティングの進行を早めることが可能となる。従って、より短時間で、厚さがサブマイクロメートルオーダーないし数十ナノメートルオーダー

ダーアで、且つ広い面積において均一な厚さを有する強誘電体結晶薄膜を製造することが可能となる。

【0043】

この場合、エッチング工程（或いは、加熱工程）は、エッチング溶液の温度制御を行うため、エッチング溶液の温度を測定する測温工程を含んでいてもよい。

【0044】

又、加熱に伴うエッチング溶液の蒸発によるエッチング溶液の減少を防ぐため、エッチング工程（或いは、加熱工程）は、該蒸発したエッチング溶液を再びエッチング溶液として還元する還流工程を含んでいてもよい。

【0045】

本発明の強誘電体薄膜製造方法に係る実施形態の他の態様では、エッチング工程は、エッチング溶液を攪拌する攪拌工程を含んでなる。

【0046】

この態様によれば、特にエッチングの進行中において、エッチング溶液の濃度を均一に保つことができ、一の面上における位置の相違によるエッチングの進行速度のバラツキを好適に防止することができる。従って、エッチングの進行を均一にすることが可能となる。

【0047】

本発明の強誘電体薄膜製造方法に係る実施形態の他の態様では、エッチング溶液中に遊離する不純物を濾過して取り除く濾過工程を含んでなる。

【0048】

この態様によれば、エッチング溶液中の不純物を濾過して除去することで、エッチング溶液の純度を高度に保つことが可能となる。従って、エッチングの進行速度の低下を抑え、また不純物の影響によるエッチングのバラツキを好適に防止することが可能となる。

【0049】

本発明の強誘電体薄膜製造方法に係る実施形態の他の態様では、他の面に膜状の電極を形成する電極形成工程と、電極と基板とを接合する基板接合工程と、強誘電体結晶の一の面を研磨する研磨工程とを備え、これらの工程に続き、上述し

たエッティング工程及び電圧印加工程を行う。

【0050】

この態様によれば、電極形成工程において、原材料となる強誘電体結晶の他の面上に電極を形成する。このように形成された電極は、上述のエッティング工程において一の面と他の面との間に電圧を印加する際の電極として利用することができる。また、本実施形態に係る製造方法により製造された強誘電体結晶薄膜を記録媒体として用いる場合には、ここで形成した電極を、記録媒体への情報を記録等するために電界を印加する際の電極として用いることもできる（詳しくは後述する）。

【0051】

続いて、基板接合工程において、電極と基板とを接合する。この接合では、後述の如く接着剤を用いて接合してもよいし、陽極接合を用いて接合してもよいし、或いはそれ以外の方法であってもよい。すなわち、電極と基板とを適切に接合できる方法であれば、方法は問わない。もっとも、電極の上に形成されている強誘電体結晶薄膜の表面の平坦を維持するために、接合は密接性に優れ、接合により不要な応力が発生せず、強誘電体結晶薄膜表面の平坦性を損なうような変形力が発生せず、経時的な変形や温度変化による変形が発生しにくいような接合方法を選択することが望ましい。

【0052】

基板には、例えばシリコン基板や強誘電体（例えば、本実施形態に係る強誘電体薄膜製造方法において原材料として用いられる強誘電体結晶と同材質の強誘電体）やガラス基板等が用いられる。或いは、これら以外であっても、後述の如く強誘電体結晶の支持体としての強度を有している材料であれば、基板として用いることができる。これにより、薄膜化されることでその強度が低下する強誘電体結晶の支持体として、基板を用いることができる。従って、基板は、強誘電体結晶と比較して、ある程度の厚みを有していることが好ましい。例えば、強誘電体結晶の厚さが100nm程度であれば、基板の厚さは0.5mm程度を有していることが好ましい。

【0053】

続いて、研磨工程において、電極及び基板を形成した強誘電体結晶の一の面側を研磨し、適度な厚さ（例えば $10\text{ }\mu\text{m}$ ）にまで薄くする。研磨の方法は、例えば、回転する砥石を用いた平面研削盤や、回転する円盤状の定盤等を用いて機械的に研磨する方法でもよいし、単純なエッティングのようないわゆる化学的研磨でもよい。研磨工程で、強誘電体結晶をおおざっぱに薄膜化し、続いて、エッティング工程及び電圧印加工程で高精度に薄膜化することで、全体的な薄膜化を効率よく行うことができ、作業の短縮化を図ることができる。

【0054】

上述の如く基板接合工程を備える強誘電体薄膜製造方法に係る実施形態の他の態様では、前記基板は、前記強誘電体結晶と比較して、熱膨張係数差が50%以内である。

【0055】

一般に、基板や強誘電体結晶等の各種部材は、温度変化に起因してその体積（或いは、面積）が膨張したり収縮したりする。従って、基板と強誘電体結晶とを接合しても、温度変化に起因した膨張等により、基板或いは強誘電体結晶との接合面の乖離や基板又は強誘電体結晶の破壊等を引き起こすおそれもある。しかるに、この態様によれば、温度変化に起因して基板と強誘電体結晶との夫々が膨張（或いは、収縮）しても、夫々の膨張等の度合いに大きな差異が生じることはない。従って、上述の如く接合面の乖離や破壊等を防ぐことができ、温度変化に強い強誘電体薄膜を比較的容易に製造することが可能となる。これは、例えば後述の如く電圧の印加により記録及び再生動作を行う場合において、この電圧の印加による温度変化に関わらず安定した記録及び再生動作が可能な強誘電体記録媒体を実現できるという点で、大きな利点を有する。

【0056】

より好ましくは、基板と強誘電体結晶との熱膨張係数が同一或いは概ね同一とすることができる程度の値を有していることが好ましい。これにより、当該強誘電体薄膜の使用時における温度変化に起因して、上述の如く接合面の乖離や破壊等を効果的に防ぐことが可能である。

【0057】

上述の如く基板接合工程を備える強誘電体薄膜製造方法に係る実施形態の他の態様では、前記基板は、前記強誘電体結晶と同一材料を含んでいる。

【0058】

この態様によれば、温度変化によらずに、基板と強誘電体結晶との膨張（或いは、収縮）の度合いは同一或いはほぼ同一となり、上述の如く接合面の乖離や破壊等をより効果的に防ぐことが可能となる。

【0059】

上述の如く基板接合工程を備える強誘電体薄膜製造方法に係る実施形態の他の態様では、基板はガラス基板であり、基板接合工程においては、電極と基板とを陽極接合により直接接合するように構成してもよい。

【0060】

このように構成すれば、例えばアルカリ金属イオンを含むガラス（即ち、ここでの基板）と金属又は半導体（即ち、ここでの電極）との間に、アルカリ金属イオンの熱拡散が生じる200°Cから400°C程度の温度で、金属側を陽極として数十から数kV程度の電圧を印加することで陽極接合を行う。従って、電極と基板とを例えば接着材等を用いることなく直接的に、且つ強固に接合することが可能となる。更に、接着面において均一な接着力を実現し、電極と基板とを密接に接合することが可能となる。このとき基板はガラス基板であって、特に陽極接合を実現するという観点からは、ナトリウムやリチウム等の陽イオン（即ち、アルカリ金属イオン）を含むガラス基板であることが好ましい。

【0061】

上述の如く基板接合工程備える強誘電体薄膜製造方法に係る実施形態の他の態様では、基板接合工程においては、電極と基板との間にガラス膜を介在させて、電極と基板とを陽極接合により接合するように構成してもよい。

【0062】

このように構成にすれば、ガラスを含まない基板であっても、ガラス膜を用いることで、陽極接合により適切に且つ強固に基板と電極とを接合することが可能となる。尚、ガラス膜は、陽極接合を行う前に予め電極上に形成しておくことが好ましい。そして、ガラス膜と基板との間に電圧を印加することで、ガラス膜中

の陽イオンの熱拡散が生じ、ガラス膜と基板とが強固に接合される。その結果、ガラス膜と基板とが強固に接合されることとなる。

【0063】

本発明の強誘電体薄膜製造方法に係る実施形態の他の態様では、基板接合工程においては、電極と基板との間に接着層を介在させて接合する。

【0064】

この態様によれば、接着層により電極と基板とを比較的容易に且つ低成本で接合することが可能となる。接着層としては、例えばエポキシ樹脂等の接着剤を用いてもよいし、或いは後述の如くロウ付け材等を用いてもよい。

【0065】

上述の如く基板接合工程において接着層を設ける強誘電体薄膜製造方法の態様では、基板接合工程においては、接着層と電極との間、並びに接着層と基板との間のうち少なくとも一方に、付着性の高い導電体下地層を介在させる。

【0066】

このように構成すれば、接着層の接合力が強固でなくとも、基板と電極とを強固に接合することが可能となる。即ち、例えば接着層としてロウ付け材を用いても、例えば付着性の高いチタンやクロムを含んでなる導電体下地層を設ければ、該導電体下地層の付着性により、強固な接合を施すことが可能となる。

【0067】

尚、このときの電極は、付着性の高い導電体下地層であることが好ましい。

【0068】

本発明の強誘電体薄膜製造方法に係る実施形態の他の態様では、研磨工程において、前記一の面を研磨した後、該一の面に対し平滑化処理を施すことで薄膜化する。

【0069】

この態様によれば、研磨工程における機械的な研磨により生じた微小な凹凸を平滑化し、その後のエッティング工程におけるエッティング精度の向上を図ることができる。ここで平滑化処理は、例えばCMP (Chemical Mechanical Polishing) 法等が用いられてもよい。

【0070】

本発明の電圧印加エッティング装置に係る実施形態の態様は、上述した本発明の強誘電体薄膜製造方法に係る実施形態（但し、その各種態様を含む）におけるエッティング工程及び電圧印加工程において用いられる電圧印加エッティング装置であって、一の面をエッティング溶液に浸すための容器と、前記一の面以外の部分をエッティング溶液よりシールするシール手段と、一の面と他の面との間に前記所定の電圧を印加する電源と、電源の一の出力端子と一の面とを電気的に接続する第1接続手段と、電源の他の出力端子と他の面とを電気的に接続する第2接続手段とを備える。

【0071】

本発明の電圧印加エッティング装置に係る実施形態によれば、上述した本発明の強誘電体薄膜製造方法に係る実施形態におけるエッティング工程及び電圧印加工程を適切に実行することが可能となる。

【0072】

具体的には、強誘電体結晶（その一の面）をエッティング溶液に浸す。このエッティング溶液は容器中に格納されている（或いは、満たされている）ことが好ましい。そして、電源より強誘電体結晶の一の面と他の面との間に所定の電圧を印加する。このとき、一の面に対しては、第1接続手段により電圧を供給する。第1接続手段は、例えば後述の如く導電性を有するエッティング溶液中に電極を浸す構成としてもよい。この構成によれば、電圧はエッティング溶液を介して強誘電体結晶の一の面に印加される。強誘電体結晶の一の面が全面に亘ってエッティング溶液に触れているとすれば、電圧は強誘電体結晶の一の面の全面に均等に印加される。この結果、強誘電体結晶内に均一な電界を形成することができる。これにより、厚さが均一な強誘電体結晶薄膜を製造することが可能となる。

【0073】

他方、他の面には、第2接続手段により電圧を供給する。第2接続手段として、例えば上述した強誘電体結晶上（他の面側）に形成される電極を用いることができる。具体的には、当該電極と電源とをリード線等で接続すればよい。

【0074】

その後は、上述したように、強誘電体結晶が目的の厚さになるまでエッチングが進行し、印加されている電圧による電界強度が強誘電体結晶の抗電界を超えたところで分極方向の反転が発生し、エッチングの進行が実質的に停止する。

【0075】

特に、シール手段により強誘電体結晶の一の面以外の部分にはエッチング溶液が触れない。従って、本来エッチングすべき一の面に対して適切にエッチングを進行させることができとなる。係るシール手段は、例えば後述の如くOリング等を含んでなるパッキンであってもよいし、或いは例えば一の面以外の部分を覆う封止缶や封止膜等であってもよい。

【0076】

以上より、本実施形態に係る電圧印加エッチング装置によれば、電圧を印加しながら、適切に強誘電体結晶の他の面に対してエッチングを進行させることができとなる。従って、上述の如く強誘電体結晶の目的厚さと強誘電体結晶の抗電界とに基づく所定の電圧を印加すれば、目的の厚さを有する強誘電体結晶を製造することが可能となる。特に、サブマイクロメートルオーダーないし数十ナノメートルオーダー程度の薄さを実現でき、且つ広い面積にわたって均一な厚さを有する強誘電体薄膜を比較的容易に製造することが可能となる。

【0077】

尚、上述した本発明の強誘電体薄膜製造方法に係る実施形態のエッチング工程及び電圧印加工程における各種態様に対応して、本発明の電圧印加エッチング装置も各種態様を探ることが可能である。

【0078】

本発明の電圧印加エッチング装置に係る実施形態の一の態様は、シール手段は、他の面に係る端部に圧着される耐酸性のOリングである。

【0079】

この態様によれば、耐酸性のOリングを用いて、比較的容易に他の面が選択的にエッチング溶液に触れるように固定することが可能となる。

【0080】

本発明の電界印加エッチング装置に係る実施形態の他の態様では、エッチング

溶液を加熱する加熱手段を更に備える。

【0081】

この態様によれば、エッティングの進行を早めることが可能となる。従って、より短時間で目的の厚さの強誘電体結晶を有する薄膜を製造することが可能となる。

【0082】

この場合、エッティング手段（或いは、加熱手段）は、エッティング溶液の温度制御を行うため、エッティング溶液の温度を測定する測温手段を含んでいてもよい。

【0083】

また、加熱に伴うエッティング溶液の蒸発によるエッティング溶液の減少を防ぐため、エッティング手段（或いは、加熱手段）は、該蒸発したエッティング溶液を再びエッティング溶液として還元する還流手段を含んでいてもよい。

【0084】

本発明の電界印加エッティング装置に係る実施形態の他の態様では、エッティング溶液を攪拌する攪拌手段を更に備える。

【0085】

この態様によれば、特にエッティングの進行中において、エッティング溶液の濃度を均一に保つことができ、一の面上における位置の相違によるエッティングの進行速度のバラツキを好適に防止することができる。従って、エッティングの進行を均一にすることが可能となる。

【0086】

本発明の電界印加エッティング装置に係る実施形態の他の態様では、エッティング溶液中に遊離する不純物を濾過して取り除く濾過手段を更に備える。

【0087】

この態様によれば、エッティング溶液中の不純物を濾過して除去することで、エッティング溶液の純度を高度に保つことが可能となる。従って、エッティングの進行速度の低下を抑え、また不純物の影響によるエッティングのバラツキを好適に防止することが可能となる。

【0088】

本発明の強誘電体結晶薄膜基板に係る実施形態は、基板と、当該基板上に形成される電極と、当該電極上に形成され、且つ厚さが $1 \mu\text{m}$ 未満の強誘電体結晶とを備えた強誘電体結晶薄膜基板であって、当該基板の表面全体の面積が 10 mm^2 以上である。

【0089】

本発明の強誘電体結晶薄膜基板に係る実施形態によれば、強誘電体結晶薄膜の厚さが $1 \mu\text{m}$ であり、且つ 10 mm^2 面積以上に及ぶ広い面積において均一な厚さであるので、この強誘電体結晶薄膜基板を、強誘電体記録媒体の材料として用いることができ、これにより、強誘電体記録媒体の量産が可能になる。

【0090】

ここで、強誘電体記録媒体は、強誘電体結晶薄膜からなる記録層を有する。そして、抗電界を超える電界を形成することができる大きさを有する電圧を強誘電体結晶薄膜に印加し、強誘電体結晶薄膜の分極方向を反転させることで情報の記録を行う。従って、強誘電体結晶薄膜の厚さが薄ければ、分極の反転に必要な（即ち、情報の記録に必要な）電圧を低くすることが可能となる。加えて、強誘電体結晶薄膜の厚さが均一であれば、情報の記録に必要な電圧を一定にすることができます。情報の記録に必要な電圧を低くすることができれば、強誘電体記録媒体に情報を記録するための記録装置の消費電力を低減させることができる。また、情報の記録に必要な電圧を一定にすれば、記録装置において、情報記録のために印加電圧を統一することができる。印加電圧を統一化することができれば、例えば印加電圧を規格化することができ、記録装置の製品化を実現することができる。更に、上述のような強誘電体記録媒体を用いることで、ナノメートルオーダーでの微小サイズの分極反転が可能となり、SNDMを再生手法とした超高密度記録再生装置が実現可能となる。

【0091】

尚、本実施形態に係る強誘電体結晶薄膜基板は、上述した本発明の強誘電体薄膜製造方法（但し、その各種態様を含む）により製造されることが好ましい。

【0092】

本発明の強誘電体結晶薄膜基板に係る実施形態の一の態様は、基板はガラス基

板であって、基板と電極とは陽極接合により直接接合されている。

【0093】

この態様によれば、基板と電極とが均一に、密接に且つ強固に接合された強誘電体結晶薄膜基板を実現することが可能となる。また、上述した本実施形態に係る強誘電体薄膜製造方法において説明したように、基板と強誘電体結晶薄膜とは熱膨張係数差が50%以内であることが好ましい。これにより、接合面の乖離や破壊等を防ぐことが可能となる。また、基板と強誘電体結晶薄膜とは同一の材料を含んでいてもよい。

【0094】

本発明の強誘電体結晶薄膜基板に係る実施形態の他の態様は、強誘電体結晶は、分極方向が表面に対して垂直方向であって、且つ同一の方向を向いている。

【0095】

この態様によれば、例えば本実施形態に係る強誘電体結晶薄膜基板を強誘電体記録媒体に利用した場合において、分極方向を同一方向に揃えるためのフォーマット処理等を別途行う必要がなくなる。

【0096】

具体的に説明すると、所定の情報を強誘電体記録媒体に記録する場合において、例えば情報に対応するデータビットが「1」の時には分極の方向を反転させ、データビットが「0」のときには、現在の分極方向を維持するといった処理を行っている。このような処理を実現するためには、情報を記録する前の初期の段階において記録媒体における強誘電体結晶薄膜の分極方向が同一方向に揃っていることが好ましい。本実施形態によれば、予め分極方向が同一方向に揃っているため、係る要請を満たすことができる。

【0097】

また、強誘電体記録媒体への情報の記録は、分極方向の変化によって行う。例えば、2値の情報を分極方向の変化によって記録するには、記録面のドメイン構造が180度ドメイン構造であることが好ましい。本実施形態によれば、強誘電体結晶薄膜の分極軸が、当該強誘電体結晶薄膜の一の面に対して垂直であるため、当該一の面を記録面とすれば、記録面のドメイン構造が180度ドメイン構造

となり、係る要請を満たすことができる。

【0098】

以上説明したように、本発明の強誘電体薄膜製造方法に係る実施形態によれば、エッティング工程及び電圧印加工程を備えている。従って、エッティング時に印加する電圧を適切に調整することで、サブマイクロメートルオーダーないし数十ナノメートルオーダーでの均一な厚さを有する強誘電体結晶の薄膜を、比較的容易に且つ効率よく製造することができる。更には、ウェハのような大面積を有する強誘電体結晶であっても、所定の電圧を印加しながらエッティングすることで、係る大面積の全体に渡って均一な厚さを有する強誘電体結晶の薄膜を製造することが可能となる。そして、本実施形態に係る製造方法により、きわめて薄く且つ平坦な面を有する強誘電体結晶ウェハを用いれば、強誘電体記録媒体の量産が可能となる。

【0099】

また、本発明の電圧印加エッティング装置に係る実施形態によれば、容器、シール手段、電源、第1接続手段及び第2接続手段を備える。従って、上述した本発明の強誘電体薄膜製造方法におけるエッティング工程及び電圧印加工程を適切に行なうことが可能となる。

【0100】

また、本発明の強誘電体結晶薄膜基板に係る実施形態によれば、基板、電極及び強誘電体結晶を備える。従って、比較的低電圧で情報の記録が可能となり、又、記録層たる誘電体が均一な厚さを有することから、記録時に必要な印加電圧の変動を抑え、印加電圧の統一化を図ることが可能となる。これにより、当該強誘電体結晶薄膜基板を、超高密度強誘電体記録を実現するための記録媒体として供することができる。

【0101】

【実施例】

以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。尚、以下に説明する強誘電体薄膜製造方法は、主として強誘電体結晶より、例えば誘電体記録媒体に利用可能な程度の薄さを有する強誘電体薄膜（以下、適宜“薄膜”と称する）を製造す

るための方法である。

【0102】

先ず、図1を参照して、本実施例に係る強誘電体薄膜製造方法に係る全体の製造工程を説明する。ここに、図1は、本実施例に係る強誘電体薄膜製造方法の全体製造工程を示すフローチャートである。

【0103】

図1に示すように、本実施例に係る強誘電体薄膜製造方法は、電極形成工程（ステップS11）、基板接合工程（ステップS12）、研磨工程（ステップS13）及びエッティング処理工程（ステップS14）を備えている。

【0104】

電極形成工程では、例えば厚さ $400\mu\text{m}$ の強誘電体結晶ウェハの一方の面（他の面）に電極を形成する。

【0105】

基板接合工程では、ステップS11において形成した電極と基板を接合する。

【0106】

研磨工程では、強誘電体結晶を例えば $10\mu\text{m}$ 程度になるまで機械的に研磨する。

【0107】

エッティング処理工程では、強誘電体結晶をエッティング溶液に浸することでエッティングを行う。そして、エッティングを行いながら、強誘電体結晶に所定の大きさの電圧を印加する。これにより、強誘電体結晶を例えば 500nm 未満の厚さにまで薄くする。

【0108】

本実施例では特に、ステップS14のエッティング処理工程において、強誘電体結晶の分極の反転によるエッティングレートの変化を利用することで、強誘電体結晶をウェハの状態のままで、 500nm 未満の厚さにすることができます。更に、エッティング面を広い範囲に渡って平坦にすることができる。係るエッティング処理工程の詳細については、後述する。

【0109】

以下、図1に示す各工程のより詳細な説明を進める。

【0110】

図2は、本実施例に係る強誘電体薄膜製造方法で用いる強誘電体結晶の原材料である強誘電体単結晶のウェハを示している。図2に示すように、強誘電体単結晶のウェハ（例えば直径100mm）を強誘電体結晶100の原材料として用いる。強誘電体結晶100は、自発分極P_sを有しており、その分極の方向（即ち、配向）は、面101（一面）から面102（他の面）に向かっている。即ち、面101側に負の電荷が発生し、面102側に正の電荷が発生しているのと同様の状態が実現されている。そして、強誘電体結晶100は、分極軸方向の正負の相違により、面101及び面102のエッティングレートに大きな差がある。

【0111】

このような強誘電体結晶100として、例えばLiNb_xTa_{1-x}O₃（但し、 $0 \leq x \leq 1$ ）、M:LiNb_xTa_{1-x}O₃（但し、 $0 \leq x \leq 1$ 、且つMはMgOやZnO等のドーピング材料）、K₃Li_{2-x}（Nb_{1-y}Ta_y）_{5+x}O_{15+2x}等がある。例えば、上述のLiTaO₃やLiNbO₃等では、面102（即ち、正の電荷が発生する側の面）のエッティングレートは、面101（即ち、負の電荷が発生する側の面）のエッティングレートと比較して小さく、面102の方が面101よりもエッティングされにくい。

【0112】

但し、強誘電体結晶100として用いる物質はこれらに限定されるものではなく、分極の方向の相違によりエッティングレートに差がある強誘電体結晶であればよい。

【0113】

また、これらの強誘電体結晶100は、結晶内部から表面（即ち、面101及び102）に至るまで均一な結晶性を保持していることが好ましい。そして、図2に示すように、分極軸が表面に対して垂直であり、且つ同一方向を向いていることが好ましい。これにより、本実施例に係る強誘電体薄膜製造方法により製造される薄膜を、後述の如く比較的容易に強誘電体記録媒体に使用することができる。

【0114】

図3は、図1中の「電極形成工程」を示している。図3に示すように、電極形成工程においては、強誘電体結晶100の面102上に膜状の電極110を形成する。なお、電極110を形成する面102は、強誘電体結晶100の現時点において設定された分極方向により、エッティングレートが低い面である。

【0115】

電極110として、例えばAuやPtなどの貴金属、AlやCrやTi等の金属材料、或いはLASCO (La_{0.5}Sr_{0.5}CoO₃)、SrRuO₃等の導電体酸化物等が用いられる。電極110は、スパッタリング法または蒸着法等によって、強誘電体結晶100の面102上に形成される。スパッタリング法および蒸着法は、それぞれ従来の技術を用いることができる。

【0116】

このとき、電極110が形成される面（即ち、電極110と面102との接合面）は、強誘電体結晶の分極軸に対して垂直となっている。

【0117】

なお、電極110は、後のエッティング処理工程において、強誘電体結晶に電圧を印加するためのエッティング電極としての機能を果たす。また、本実施例に係る製造方法によって製造された強誘電体結晶薄膜が強誘電体記録媒体として用いられるときには、電極110は、当該記録媒体に電界を印加するときの電極として利用される。

【0118】

続いて、図4から図7は、図1中の「基板接合工程」を示している。基板接合工程における基板接合の方法には、例えば4つの方法がある。図4から図7はこれらの4つの方法を夫々用いた基板接合工程の4つの具体例を示している。

【0119】

図4に示すように、基板接合工程の第1の具体例は、接着剤111を用いて電極110と基板120とを接合する。該接着剤111として、例えばエポキシ樹脂やアクリレート樹脂等を用いてもよい。これにより、比較的容易に且つ低コストにて電極110と基板120とを接合することができる。

【0120】

この場合、基板120として例えばシリコン基板、ガラス基板或いは強誘電体結晶100と同材質の又は異材質の強誘電体等を使用することができる。そして、基板120は強誘電体結晶100の支持体となるものであるから、基板120の厚さは、強誘電体結晶100の厚さ（エッティング処理工程が終了した後の薄膜化した強誘電体結晶100）と比較して厚いことが好ましい。例えば、電極110のエッティング処理後の最終的な厚さ（目的厚さ）が100nmであり、接着剤111の厚さが0.5μmであり、基板120の厚さが0.5mm程度である。

【0121】

図5に示すように、基板接合工程の第2の具体例は、ロウ付け材113を用いて電極110と基板120とを接合する。このとき、電極110として、付着性の高い導電体下地層112を用いる。加えて、ロウ付け材113と基板120との間にも導電体下地層112を設ける。

【0122】

導電体下地層112は、例えば付着性の高いA1やTiやCrを用いることが好ましい。これにより、ロウ付け材113と導電体下地層112や基板120等との接着をより確実に行うことが可能となる。係る導電体下地層112は、概ね30nm程度の厚さがあればよいが、これに限定されるものでなく、ロウ付け材113と導電体下地層112や基板120等との付着を行うことができる程度の厚さであればよい。また、導電体下地層112も上述の電極110と同様に、スパッタリング法や蒸着法により強誘電体結晶100上に或いは基板120上に形成することができる。

【0123】

そして、強誘電体結晶100とロウ付け材113との間に設けられる導電体下地層112は、電極110となり、エッティング処理工程における電極、及び誘電体記録媒体として電極として用いられる。

【0124】

また、ロウ付け材113は、例えばAuやSnを含んでなることが好ましい。これらのAuやSnを別々に或いは合金の状態で、接合面に対してスパッタリン

グ法等を用いて例えば薄膜状に堆積させる。その後、該接合面を付着すべく、少なくとも接合面に対し概ね300℃程度の加熱を加え、導電体下地層112とロウ付け材113とを、並びにロウ付け材113と基板120（即ち、導電体下地層112が形成されている面）とを夫々相互に接着させる。

【0125】

図6に示すように、基板接合工程の第3の具体例は、陽極接合により電極110と基板120とを接合する。この場合、電極110と基板120との間にガラス膜114を配置する。

【0126】

即ち、図6（a）に示すように、電極110のうち強誘電体結晶100との接合面とは反対側の面に対し、ガラス膜114を形成する。ガラス膜114は、例えばパイレックス（登録商標）ガラス等のように、NaやLi等のアルカリ金属を含んでいるガラスを用いることが好ましい。

【0127】

そして、図6（b）に示すように、ガラス膜114に更に基板120を密着させた後、400℃程度に加熱し、且つガラス膜114と基板120との間に600V程度の電圧を印加する。このとき、ガラス膜114側を陰極とすることが好ましい。これにより、NaイオンやLiイオン等のアルカリ金属イオンが熱拡散し、基板120との界面付近に移動することで、強固で、均一な接着力を有し且つ信頼性の高い接合がなされることとなる。更に、図4及び図5に示すように接着層（即ち、接着材111、導電体下地層112及びロウ付け材113）を使用することなく、基板120と電極110とを強固に接合することができる。

【0128】

一方、図7に示すように、基板接合工程の第4の具体例では、例えばNa等のアルカリ金属を含むガラス基板121を用いて、ガラス基板121と電極110との間で直接陽極接合を行う。これにより、図6のようにガラス膜114を用いることなく、電極110とガラス基板121とを陽極接合により強固に、均一に且つ密接に接合することができる。

【0129】

尚、図7に示すようにガラス基板121を用いて陽極接合を行う第4の具体例では、電極110は、例えばAl、Cr、Ti等の金属材料を含んでなることが好ましい。

【0130】

尚、図6及び図7に示す陽極接合においては、400℃程度での加熱及び600V程度の電圧印加による、強誘電体結晶100や電極110やガラス膜114や基板120やガラス基板121等の熱膨張等を考慮することが好ましい。即ち、熱膨張によっても、基板120とガラス膜114とが、又はガラス基板121と電極110とが適切に接合するように、例えば基板120等の位置合わせ等において考慮することが好ましい。

【0131】

加えて、基板120と強誘電体結晶100との熱膨張係数の差が50%以内であるような材料からなる基板120を用いることが好ましい。より好ましくは、基板120と強誘電体結晶100とが同一の材料（即ち、同一の強誘電体材料）であってもよい。これにより、上述したように、温度変化に起因した基板120と強誘電体結晶100との接合面の乖離や破壊等を防ぐことができる。これは、後述の如く電圧の印加により情報の記録及び再生を行う情報記録媒体の材料として大きな利点となる。即ち、電圧の印加により強誘電体結晶100の温度が上昇し膨張したとしても、基板120も同様の或いは概ね同様の割合で膨張するため、接合面の乖離や破壊等を防ぐことができ、情報記録媒体として適切に使用することができる。

【0132】

また、陽極接合に限らずその他の直接接合法（即ち、接着剤111やロウ付け材113等を用いない方法）を用いてもよいし、或いはその他電極110と基板120（ガラス基板121）を適切に接合できる方法であってもよい。

【0133】

加えて、図4から図7における基板120及びガラス基板121は、強誘電体結晶100よりも厚いことが好ましい。これにより、強誘電体結晶100のロスを最小に抑えることができると共に、該基板120又はガラス基板121を薄膜

化された強誘電体結晶100の支持体とすることが可能となる。

【0134】

更に、基板120として、強誘電体結晶100と同一材料の強誘電体を用いる場合には、基板120と強誘電体結晶100との夫々の結晶方位の位置関係が同一であってもよい。

【0135】

続いて、図8は、図1中「研磨工程」を示している。図8に示すように、基板120を接合した後の強誘電体結晶100のうち電極110等を形成していない側の面（一の面側）を、平面研削或いは一般的な回転定盤等により研磨する。該研磨により強誘電体結晶100を10μm程度にまで薄くする。これにより、後のエッティング処理工程においてエッティングすべき強誘電体結晶100の部分を減少させることができ、薄膜化作業の効率化を図ることが可能となる。

【0136】

尚、研磨工程における強誘電体結晶100の面101に係る平行度はマイクロメートルオーダーであってもよい。すなわち、本製造方法においては、最終的な強誘電体結晶100の面101の平行度は、数十ナノメートルオーダーないしナノメートルオーダーであるが、研磨工程の段階では、このような高精度な平行度を確保することは、必ずしも必要ない。なぜなら、後のエッティング処理工程において、数十ナノメートルオーダーないしナノメートルオーダーの平行度を得ることができるのである。

【0137】

なお、研磨工程では、機械研磨の後に、CMP (Chemical Mechanical Polishing) 法により、強誘電体結晶100の表面の加工変質層を除去しておくことが好ましい。これにより、後のエッティング処理工程におけるエッティングムラを低減し、加工精度及び加工速度を高めることができる。

【0138】

続いて、図9から図11は、図1中の「エッティング処理工程」を示している。

【0139】

先ず図9は、エッチング処理工程において用いられる電圧印加エッチング装置を示している。図9 (a) に示すように、本実施例に係る電圧印加エッチング装置200は、耐酸容器201と、Oリング202と、電極203と、エッチング溶液204と、電源205と、電極取出線206と、固定具207とを含んでなる。そして、電圧印加エッチング装置200は、強誘電体結晶100に対してウエットエッチングを行うために用いられる。

【0140】

耐酸容器201は、エッチング溶液204を満たすエッチング槽であると共に、強誘電体結晶100等を固定し保持する固定部としての機能をも有する。耐酸容器201は、エッチング溶液204に直接触れるため、テフロン（登録商標）等の絶縁性耐酸性の材料を含んで構成されることが好ましい。

【0141】

そして、電極取出線206と電源205とが接続可能なように、容器201には電極取出線206が通過可能な通路が形成されている。

【0142】

Oリング202は、本発明における「シール手段」の一具体例であり、エッチング溶液204が強誘電体結晶100の面101以外の面に触れることのないように、エッチング溶液204の漏れを防止する。加えて、電極110と電極203とを電気的に絶縁する。Oリング202は、面101の外周に沿って密着するように配置する。又、Oリング202もエッチング溶液204に直接触れるため、耐酸性の材料を含んで構成されることが好ましい。

【0143】

電極203は、本発明における「第1接続手段」の一具体例であり、エッティング溶液204を介して強誘電体結晶100の面101に電圧を印加するための電極である。電極203は、エッティング溶液204に直接浸されるため、例えばPt等の耐酸性を有する金属電極であることが好ましい。

【0144】

また、エッチングのための電圧印加に用いるもう一方の電極は、強誘電体結晶100の面102上に形成された電極110（或いは、導電体下地層112）を

用いることができる。従って、電圧印加エッチング装置200は、該電極110と電源205とを接続可能に構成されていることが好ましい。例えば、図9(a)に示すように、電極110より耐酸容器201の一部に引き出し線等(例えば、電極取出線206)を備えており、該引き出し線が電源205に接続されるように構成してもよい。

【0145】

エッチング溶液204は、例えばフッ酸等の強酸を含んでなり、化学的に強誘電体結晶100の面101を侵食し、これを目的厚さにする。このエッチング溶液204は、耐酸容器201により構成されるエッチング槽に満たされる。

【0146】

電源205は、電極110と電極203との間に直流電圧を加え、エッチングの進行を制御する。本実施例では特に、電源205の供給する電圧を予め所定の値に設定しておくことで、強誘電体結晶100を目的厚さにまで薄くすることが可能となる。係る数値の関係については、後に詳述する(図10参照)。

【0147】

また、電源205の各種パラメータ(例えば、電圧値、電流値、印加時間、極性、電圧波形等)を設定または制御する制御部を備えていてもよい。該制御部は、例えばC P U等により自動的に制御可能なものであってもよいし、或いはキーボードや操作ボタン等の如く外部より手動制御可能なものであってもよい。

【0148】

電極取出線206は、本発明における「第2接続手段」の一具体例であり、例えば電極110との接点部材や銅線等を含んでなり、容器201中に固定した強誘電体結晶100(基板120等を含む)が有する電極110に電源205より供給される電圧を印加する。そして、容器201中に強誘電体結晶100を固定すれば、該固定と同時に電極取出線206と電極205とが接することが好ましい。これにより、電極205に対し、比較的容易に電源205より電圧を印加することが可能となる。

【0149】

固定具207は、耐酸容器201を固定するために用いられる。また、固定具

207による固定を解除することで、エッチングを行う強誘電体結晶100（基板120等を含む）を当該電界エッチング装置200に備え付け、且つエッチングが終了した強誘電体結晶100（基板120等を含む）を取り出すことができるように構成されていることが好ましい。

【0150】

尚、図9（b）に示す電圧印加エッチング装置200aの如く、更にヒータ208、攪拌部209及び濾過ポンプ210を備えるように構成してもよい。

【0151】

ヒータ208は、エッチング溶液204を加熱するために用いられる。ヒータ208は、例えばニクロム線等の導線（但し、該導線は溶解を防ぐためエッチング溶液204から遮断されており、かつ導電性を有するエッチング溶液と絶縁されている）や該導線に電流を供給する電源等を含んでいることが好ましい。これにより、エッチングの進行速度を速めることができ、より効率的にエッチングを行うことが可能となる。

【0152】

攪拌部209は、エッチング溶液204の濃度を均一に保つため、規則的に或いは不規則的にエッチング溶液204を攪拌可能に構成されている。例えばモーターやプロペラ（或いは、攪拌棒等）を含んでいることが好ましい。これにより、面101に対するエッチングが均一に進めることができ可能となる。

【0153】

濾過ポンプ210は、エッチング溶液204中に遊離する不純物を濾過する。例えば濾過フィルターや、エッチング溶液を取水し且つ濾過後に開放するポンプ等を含んでいることが好ましい。これにより、エッチングの進行と共にエッチング溶液204中に遊離する不純物を取り除き、効率的なエッチングを行うことが可能となる。

【0154】

加えて、ヒータ208によりエッチング溶液204が加熱される場合には、エッチング溶液204の蒸発が促進されることとなる。従って、蒸発したエッチング溶液204を再びエッチング槽へ還流させる還流部を備えていてもよい。該還

流部は、例えば蒸発したエッティング溶液204を集める集蒸気部や集めた蒸気を例えば冷却して液化させる冷却液化部等を含んでいることが好ましい。また、エッティング溶液204を加熱する場合には、エッティング溶液204の温度制御に用いられる、例えば水銀温度計や熱電対温度計等の測温部を備えていてもよい。

【0155】

続いて、図10は、エッティング処理工程の進行の過程を示している。尚、図10における過程の説明においては、強誘電体結晶100として、Z-cut LiTaO₃を用いているものとして説明を進める。また、図10においては、図9に示した電圧印加エッティング装置200を簡略化して示すものとし、また、エッティング溶液204に実際に触れているのは、強誘電体結晶200の面101のみであり、且つ電極110と電極203とは絶縁されているものとする。

【0156】

図10(a)に示すように、エッティング溶液204中にある強誘電体結晶100の分極方向は面101から面102に向かう方向に予め設定されている。この結果、エッティング溶液204に接している面101はマイナス面である。LiTaO₃は、プラス面よりもマイナス面の方がエッティングレートが大幅に大きい。このため、面101はエッティングが速く進行する。

【0157】

また、図10(a)に示すように、エッティング処理を行うときには、電極110を電源205の陽極側に接続し、且つ電極203を電源205の陰極側に接続して、電源205を駆動する。これにより、エッティング溶液204内にある強誘電体結晶100に所定の電圧が印加され、強誘電体結晶100内に電界が形成される。このとき、強誘電体結晶100に分極方向と、強誘電体結晶100内に形成されている電界とは逆極性である。

【0158】

強誘電体結晶100に加える所定の電圧は、これをV_{DC}とし、当該強誘電体結晶100であるLiTaO₃の抗電界を「E_c」とし、当該エッティング処理によって強誘電体結晶100に設定する厚さを「目的厚さd」とすると、V_{DC} = E_c × dである。すなわち、このような電圧V_{DC}を強誘電体結晶100に印加

するように、電源205の電圧を設定する。具体的には、LiTaO₃の抗電界E_cは22kV/mmであるので、目的厚さdを例えば100nmとすれば、電圧Vは、2.2Vとなる。

【0159】

エッティング処理の開始時は、まだ、エッティングが進行していないので、強誘電体結晶100の厚さは、研磨工程直後の厚さ（例えば10μm）である。したがって、現時点では、2.2Vの電圧V_{DC}を、この強誘電体結晶100に印加しても、その分極方向は反転しない。

【0160】

さて、エッティングが進行し、強誘電体結晶100の厚さが薄くなっていく。そして、図10（b）に示すように、強誘電体結晶100の厚さが目的厚さdに達したとき、この厚さdに相当する部分（即ち、図中100bにて示される部分）における誘電体結晶100の分極方向が反転する。なぜなら、強誘電体結晶100が目的厚さdになると、強誘電体結晶100に現在印加されている電圧V_{DC}により強誘電体結晶100中に生じる電界が、当該強誘電体結晶100の抗電界を超えるからである。

【0161】

ここで、上述したように、LiTaO₃は、マイナス面に比較して、プラス面のエッティングレートが大幅に小さい。このため、エッティング溶液204がマイナス面に対して適度なエッティングレートをもたらすエッティング溶液であっても、プラス面に対しては、エッティングされないに等しいようなきわめて小さいエッティングレートしかもたらさない。すなわち、実質的にみて、プラス面は、エッティング溶液204によってエッティングされないといってよい。従って、強誘電体結晶100の分極方向の反転により、今までマイナス面であった面101の部分がプラス面100bになると、当該部分については、実質的に、エッティングの進行が停止する。この結果、エッティングの進行は、目的厚さdで停止するのである。

【0162】

従って、強誘電体結晶100の抗電界E_cを予め知り、かつ、目的厚さdを予め決定し、これらに基づいて、電源205の電圧V_{DC}を予め設定しておけば、

強誘電体結晶100を目的厚さdとなるまで、高精度にエッティングすることができる。

【0163】

エッティングの進行に若干でもバラツキがあれば、強誘電体結晶100の厚さが目的厚さdに達するのに時間差が生じるかもしれない。しかし、例えば、先に目的厚さdに達した部分100bは、エッティングの進行が停止しているので、まだ目的厚さdに達していない部分100aのエッティングが進行している間、部分100bは目的厚さdを維持している。

【0164】

やがて、強誘電体結晶100のすべての部分の厚さが目的厚さdとなり、エッティングの進行が完全に停止する。この結果、強誘電体結晶100は、全面に亘って厚さがdとなり、かつ表面全体が平坦な面となる。

【0165】

以上より、本実施例に係る製造方法によれば、大面積を有する強誘電体結晶ウェハであっても、エッティングの際の電圧を適切に調整し、きわめて薄く、且つ均一な厚さを有する強誘電体薄膜の製造が可能となる。そして、このようにして製造した強誘電体薄膜を材料として、強誘電体記録媒体の量産が可能となる。

【0166】

尚、エッティング溶液204等が室温程度の温度では、エッティングの進行速度が遅い（即ち、エッティングレートが小さい）ため、ヒータ208を用いて、例えば80°C程度にまでエッティング溶液204を加熱することが好ましい。

【0167】

尚、図10においては、LiTaO₃を用いて説明したが、それ以外の強誘電体結晶（例えば、上述したLiNbO₃等）であっても、分極の正負の相違によりエッティングレートに差がある強誘電体結晶であれば、同様に目的の厚さにまで薄くすることが可能となる。

【0168】

尚、電源205は、直流電圧を供給するのみならず、例えば図11に示すようにパルス電圧を供給するように構成してもよい。このようなパルス電圧を供給す

る場合には、例えば上述の制御部により、パルス電圧の強度、パルス幅、或いはデューティー比等を適宜調整することで、エッティングの制御性（例えば、微細加工性やエッティング速度等）を向上させることが可能となる。

【0169】

特に、直流電圧を印加する場合には、電気化学的な作用が強誘電体結晶100に及ぶこともあり、本来エッティングされにくい面（即ち、例えばLiTaO₃たる強誘電体結晶100であれば、分極の方向がプラスの面）のエッティングレートが増加してしまうおそれもある。しかるに、図11に示すようにパルス電圧を印加することで、電気化学的作用を及ぼさない程度の適切な電圧を印加し、より適切なエッティングを行うことが可能となる。

【0170】

尚、パルス電圧を供給する場合であっても、上述した直流電圧を供給する場合と同様に制御部を備えていてもよい。例えば、電源205の各種パラメータ（例えば、上述した各種パラメータに加えて、パルス電圧の強度、パルス幅、デューティー比等）を制御可能であってもよい。

【0171】

また、上述した本実施例に係る強誘電体薄膜製造方法に用いられる各種装置を組み合わせて、薄膜製造装置とすることもできる。即ち、例えばスパッタリング装置や陽極接合装置、電圧印加エッティング装置を組み合わせて薄膜製造装置とすることで、該薄膜製造装置を用いて、上述した各種利益を有する強誘電体結晶を含む薄膜を製造することが可能となる。

【0172】

続いて、上述した本実施例に係る強誘電体薄膜製造方法により作成した強誘電体結晶薄膜基板を、強誘電体記録媒体に適用した場合の例を挙げる。

【0173】

図12に示すように、本実施例に係る製造方法により製造された強誘電体結晶薄膜基板は、例えば、ディスク状の誘電体記録媒体300として用いることができる。即ち、強誘電体結晶100が記録層となり、電極100がそのまま誘電体記録媒体300の電極として用いられ、基板120は、そのまま誘電体記録媒体

300の支持体として用いることができる。尚、図12では、接着剤111等を省略している。また、本実施例に係る製造方法により製造された大面積の強誘電体結晶薄膜基板を矩形に切り分けて、マルチプローブによるx-yスキャン記録再生用の記録媒体としても用いることができる。

【0174】

図13に示すように、情報は、強誘電体記録媒体300の強誘電体結晶100の局所的な分極方向によって記録される。例えば、情報のデータビットが「1」であれば、上向きの分極方向として記録され、情報のデータビットが「0」であれば、下向きの分極方向として記録されるが如きである。情報の記録は、強誘電体結晶100に、実際上の抗電界を超える電界を印加することによって行う。具体的には、プローブ310と電極110との間に、情報（データビット列）に対応する電圧パルス信号を印加し、例えば、パルスがハイレベルのときに限り、強誘電体結晶100に抗電界を超える電界が形成されるようとする。そして、このような電圧パルス信号の印加を、プローブ310と記録媒体300との位置関係を図中の矢示方向に変化させながら行う。これにより、抗電界を超える電界が形成された部分に限り、分極方向が反転する結果、情報が強誘電体結晶100に記録される。

【0175】

上述した製造方法により製造した強誘電体結晶100は、製造直後においては、分極方向が同一方向に揃っている。そして、これらの分極方向は、記録面に対して垂直である。したがって、情報を分極方向の反転により記録する強誘電体記録媒体300として、直ちに利用することができる。この結果、当該誘電体記録媒体300を用いる際に、分極方向を揃えるなどのフォーマット作業をする必要がないという利点を有する。

【0176】

そして、上述した製造方法により製造した強誘電体結晶100は、その厚さが100nm程度と薄い。したがって、強誘電体結晶100の分極方向を反転させるために電圧、すなわち、情報を記録するための記録電圧パルスの電圧を低くすることができ、記録装置の消費電力を抑えることができる。

【0177】

また、上述した製造方法により製造した強誘電体結晶100は、その厚さが均一である。したがって、強誘電体結晶100の分極方向を反転させるために電圧、すなわち、情報を記録するための記録電圧パルスの電圧を一定にすることができる。

【0178】

尚、本発明の実施例の説明に用いた図面は、本発明の強誘電体薄膜製造方法、電圧印加エッチング装置、並びに薄膜の構成要素等を、その技術思想を説明する限りにおいて具体化したものであり、各構成要素等の形状、大きさ、位置、接続関係などは、これに限定されるものではない。

【0179】

また、本発明は、請求の範囲及び明細書全体から読み取ることできる発明の要旨又は思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を伴う強誘電体薄膜製造方法及び装置、電圧印加エッチング装置、並びに薄膜もまた本発明の技術思想に含まれる。

【図面の簡単な説明】**【図1】**

本発明の強誘電体薄膜製造方法に係る実施例の全体製造工程を示すフローチャートである。

【図2】

本発明の強誘電体薄膜製造方法に係る実施例において用いられる強誘電体結晶を概念的に示す断面図である。

【図3】

本発明の強誘電体薄膜製造方法に係る実施例における、電極形成工程後の強誘電体結晶を概念的に示す断面図である。

【図4】

本発明の強誘電体薄膜製造方法に係る実施例における、基板接合工程による基板接合の一の態様を概念的に示す断面図である。

【図5】

本発明の強誘電体薄膜製造方法に係る実施例における、基板接合工程による基板接合の他の態様を概念的に示す断面図である。

【図6】

本発明の強誘電体薄膜製造方法に係る実施例における、基板接合工程による基板接合の他の態様を概念的に示す断面図である。

【図7】

本発明の強誘電体薄膜製造方法に係る実施例における、基板接合工程による基板接合の他の態様を概念的に示す断面図である。

【図8】

本発明の強誘電体薄膜製造方法に係る実施例における、研磨工程の態様を概念的に示す模式図である。

【図9】

本発明の強誘電体薄膜製造方法に係る実施例における、エッティング処理工程において用いられる電圧印加エッティング装置の基本構成を概念的に示す断面図である。

【図10】

本発明の強誘電体薄膜製造方法に係る実施例における、エッティング進行の過程を概念的に示す模式図である。

【図11】

本発明の強誘電体薄膜製造方法に係る実施例における、エッティング処理工程において引火されるパルス電圧を示すグラフである。

【図12】

本発明の強誘電体薄膜製造方法に係る実施例により製造された薄膜を用いて作成された誘電体記録媒体を概念的に示す斜視図である。

【図13】

図12に係る誘電体記録媒体に情報を記録し、又は該情報を再生する誘電体記録装置のプローブ部分を概念的に示す説明図である。

【符号の説明】

100・・強誘電体結晶

101…マイナス面

102…プラス面

110…電極

111…接着剤

112…導電体下地層

113…ロウ付け材

114…ガラス膜

120…基板

121…ガラス基板

200…電圧印加エッチング装置

202…Oリング

203…電極

204…エッチング溶液

205…電源

206…電極取出線

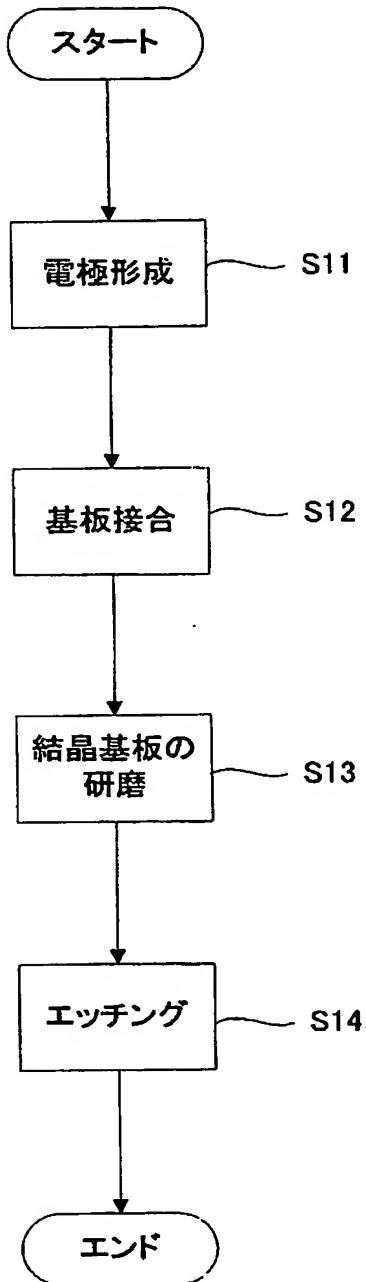
300…誘電体記録媒体

310…プローブ

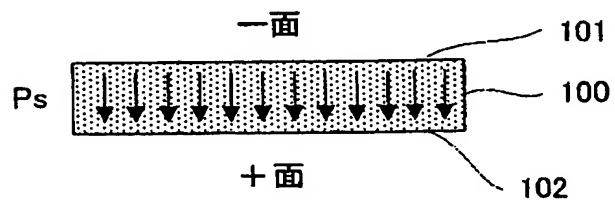
【書類名】

図面

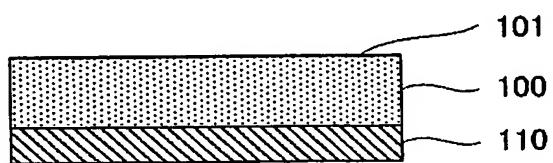
【図 1】



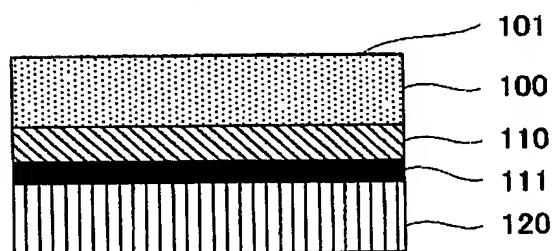
【図 2】



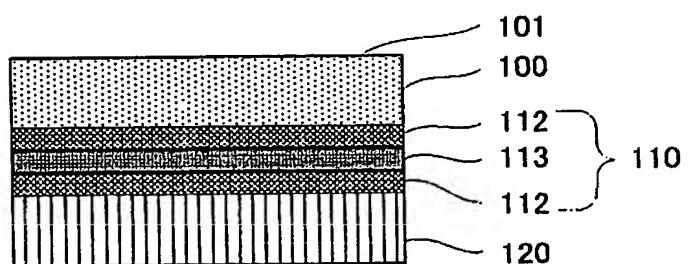
【図 3】



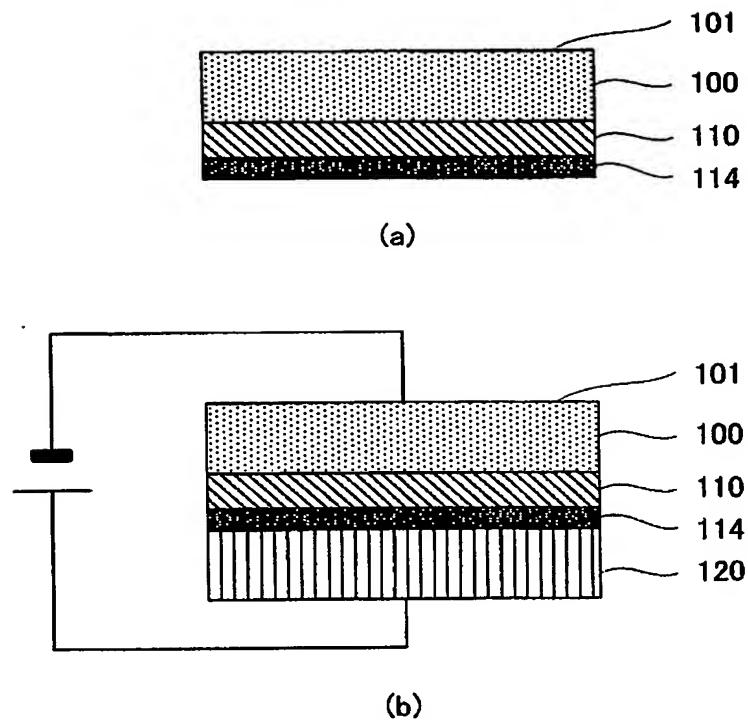
【図 4】



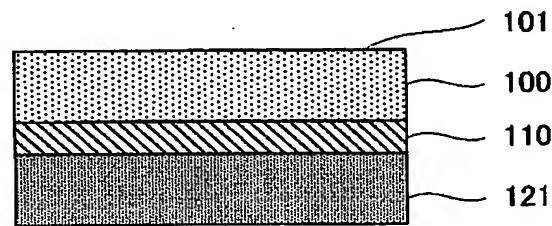
【図 5】



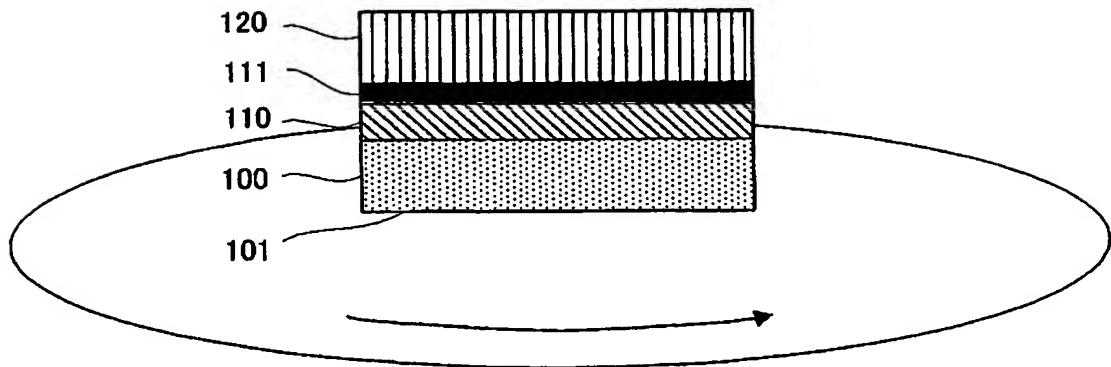
【図 6】



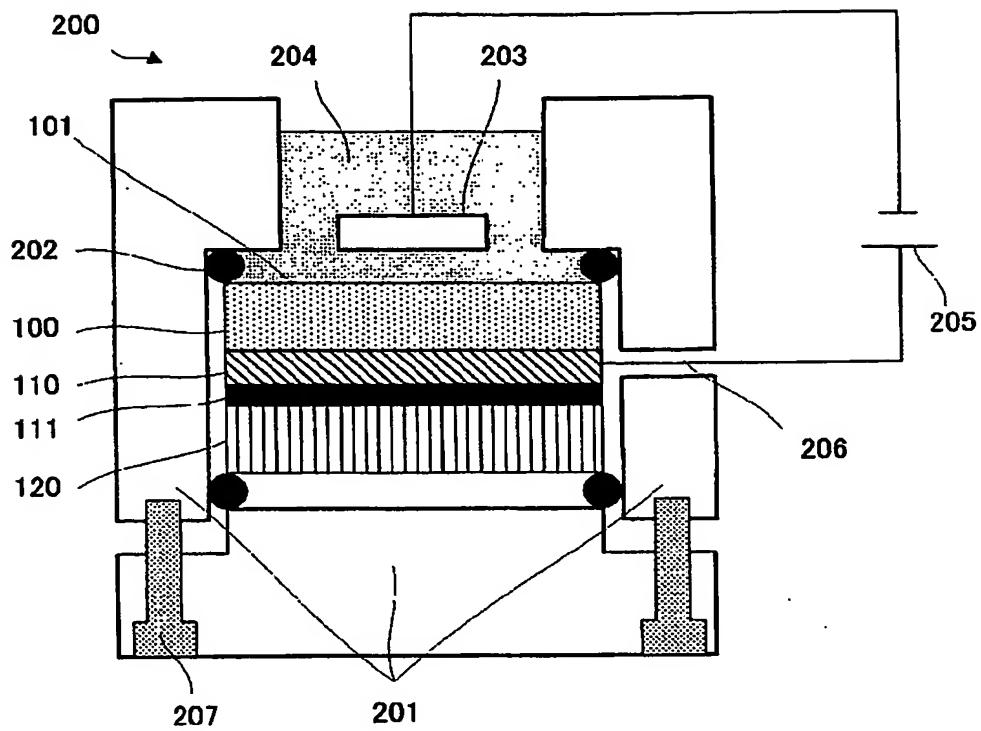
【図 7】



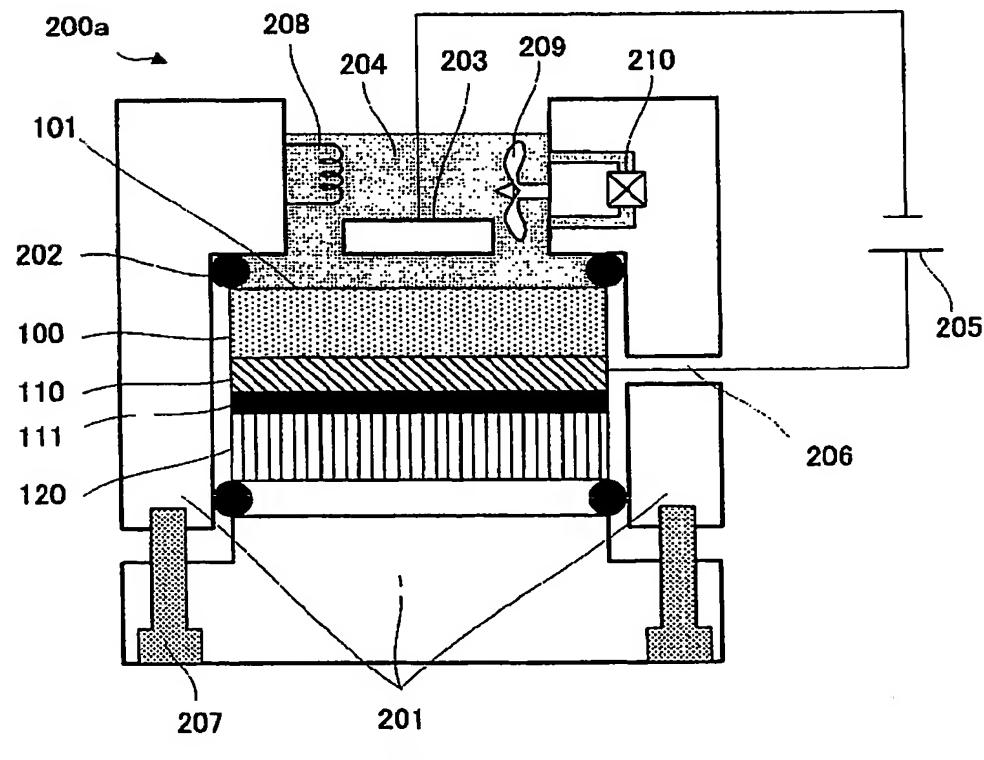
【図 8】



【図9】

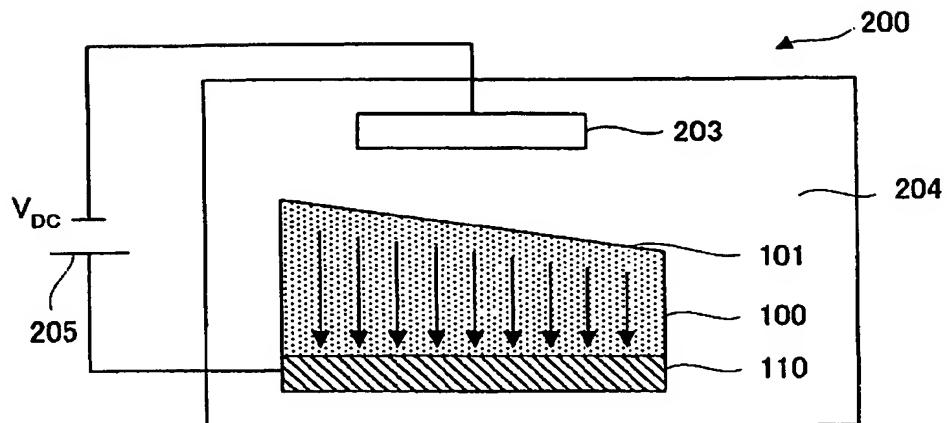


(a)

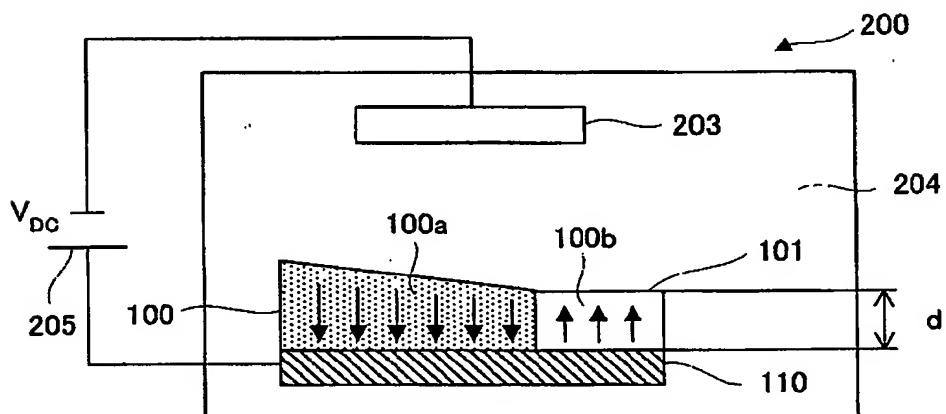


(b)

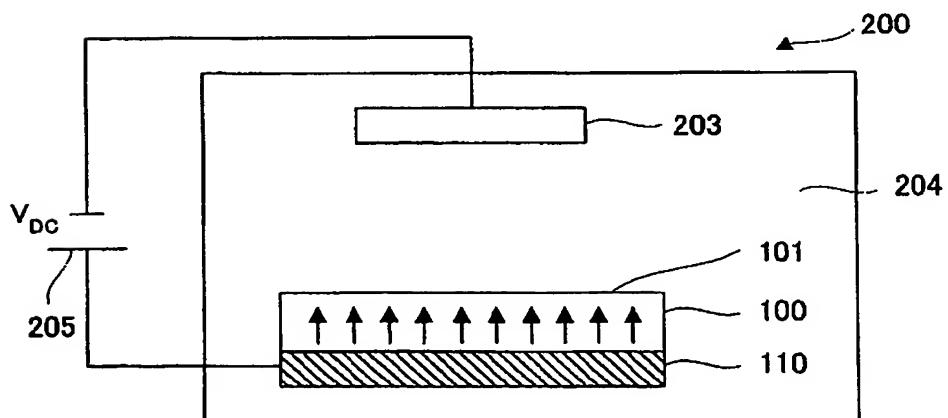
【図10】



(a)

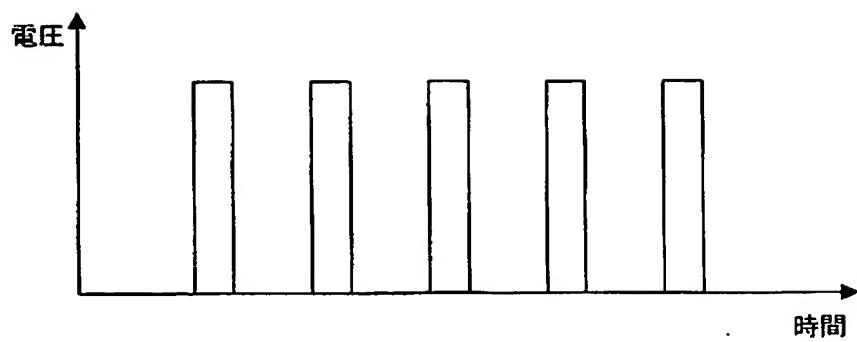


(b)

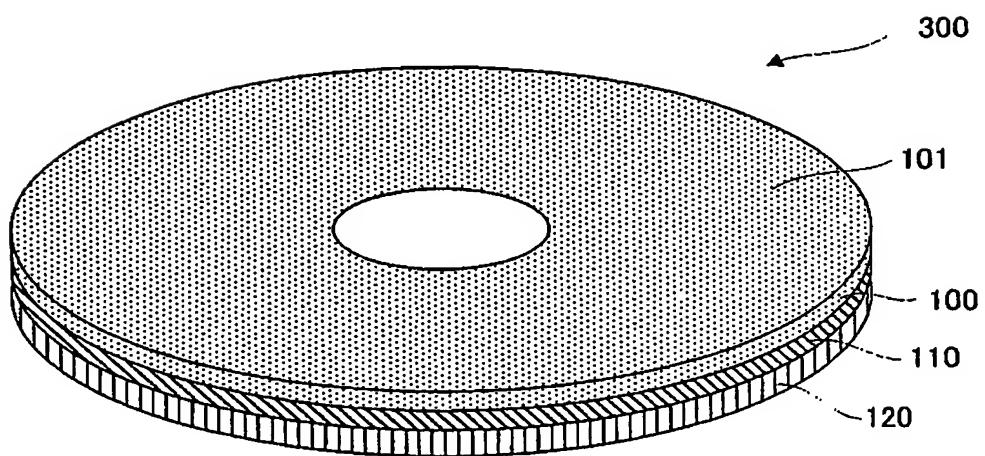


(c)

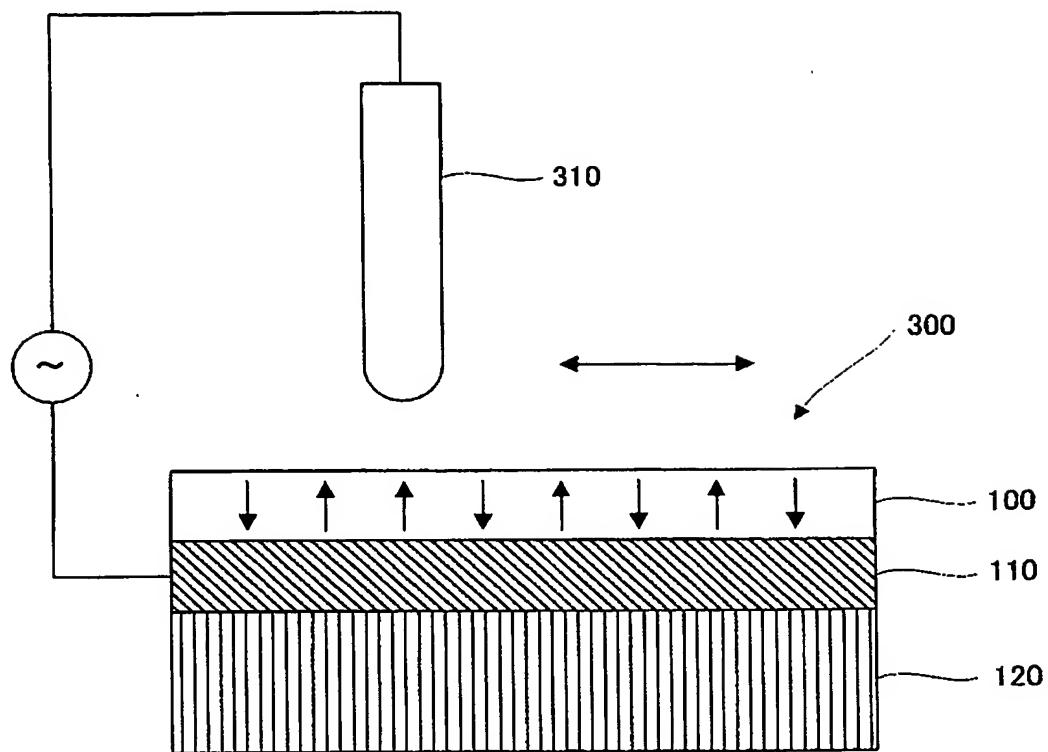
【図11】



【図12】



【図13】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 きわめて薄くかつ広い面積において均一な厚さを有する強誘電体結晶薄膜を製造する。

【解決手段】 互いに向かい合う一の面と他の面とを有し、且つ分極方向が一方に向に揃った状態で一の面のエッティングレートが他の面のエッティングレートよりも大きい強誘電体結晶を用い、この強誘電体結晶の一の面に対してエッティングを行う。エッティングを行うと同時に、この強誘電体結晶に所定の電圧を印加する。これにより、エッティングが進行して、強誘電体結晶の厚さが目的厚さに達すると、強誘電体結晶の分極方向が反転し、エッティングの進行が自動的に停止する。この結果、きわめて薄く、かつ広い面積において均一な厚さを有する強誘電体結晶薄膜を製造することができる。

【選択図】 図10

特願 2003-208221

出願人履歴情報

識別番号 [501077767]

1. 変更年月日 2001年 2月 26日

[変更理由] 新規登録

住 所 宮城県仙台市青葉区米ヶ袋 2-4-5-304
氏 名 長 康雄

特願 2003-208221

出願人履歴情報

識別番号 [000005016]

1. 変更年月日 1990年 8月31日

[変更理由] 新規登録

住所 東京都目黒区目黒1丁目4番1号
氏名 パイオニア株式会社